1. EVT
   1. Kick off
   2. 需求分析
      1. 硬件需求分析
         1. 硬件SPEC分析
      2. 软件需求分析
      3. 结构需求分析
      4. 需求评审
   3. 首版设计
      1. 硬件设计
         1. 原理图设计
         2. PCB Layout
      2. 软件设计
      3. 结构件设计
      4. 设计评审
   4. EVT首样
      1. 硬件打样
         1. 元器件采购
         2. PCB采购
         3. PCBA贴片
      2. 结构件打样
         1. 3D首样
      3. 样品验证
         1. 硬件验证
         2. 软件验证
         3. 结构件验证
      4. EVT评审
2. DVT
   1. 设计修正
      1. 硬件修正
      2. 软件修正
      3. 结构件修正
      4. 修正评审
   2. DVT打样
      1. 硬件打样
      2. 结构件打样
         1. 3D打样
         2. 供应商开模首样
      3. 样品验证
      4. DVT评审定样
3. PVT
   1. PVT打样
      1. 硬件打样
      2. 结构件修模
   2. 样品评审
      1. BOM评审
      2. 软件评审
      3. SOP评审
      4. QC/OQC评审
   3. PVT定稿
      1. SOP输出
      2. QC/OQC输出
      3. BOM输出
      4. 固件输出